

### 未來計劃

本公司之目標為乘著消費電子及通訊電子業興起外判趨勢，掌握當中持續增長之機遇，以提升盈利及盡量擴大股東價值。為達致此目標，本公司擬積極參與消費電子及通訊電子業內增長強勁、高利潤兼大量生產之範疇，透過向該等行業內具領導地位之環球知名客戶提供一站式生產解決方案，並推行以下計劃，繼續自本公司強勁產能產生收益：

- 投放更多資源購置更先進設備，增加於消費及通訊電子裝置內使用倒裝晶片，另外派遣工程人員前往日本等其他有關科技發展較為成熟之國家，裝備彼等有關操作該等技術之專門知識。倒裝晶片技術為頂尖技術，取代採用引線接駁至電路板之正面晶片。此項技術目前並未廣泛應用於印刷線路板裝配及電子製造服務行業，現時主要應用於流動電話及攝錄機之印刷線路板裝配。本公司計劃於蘇州新廠房採用此項技術；
- 透過增聘經驗豐富，且具備當地知識及人際網絡之銷售代表，擴充銷售及市場推廣隊伍，以助本公司藉於韓國及美國等其他地區拓展客戶關係，擴闊客戶基礎；
- 於二零零六年第三季將加工廠房遷往位於深圳沙井之新廠房，藉以擴大產能。本公司之產能將透過於二零零六年年底前在蘇州興建新廠房進一步擴大。蘇州廠房將於二零零七年第二季投入運作，主要進行需要倒裝晶片技術之高檔產品之生產；
- 於本公司RMA中心配備更先進技術，以提升及擴充售後服務，涵蓋由維修產品，以致零件管理、退貨加工與倉貯、退貨分析以至保養維修與實地工程服務等；及
- 透過購置有關企業資源規劃系統之軟件，改善管理資訊系統。

## 未來計劃及全球發售所得款項用途

### 全球發售所得款項用途

扣除本集團就全球發售應付之有關開支後，假設發售價為建議發售價範圍每股1.60港元至2.30港元之中位數每股1.95港元及超額配股權並無獲行使，預計全球發售所得款項淨額將約為433,000,000港元。董事現擬按下表所載方式動用該筆所得款項淨額：

用途	按假設以下價格計算之所得款項用途		
	最低指標價	指標價中位數	最高指標價
	1.60港元 百萬港元	1.95港元 百萬港元	2.30港元 百萬港元
• 於蘇州設立新廠房			
– 興建及裝修新廠房	90	90	90
– 購置土地	15	15	15
• 於深圳設立新廠房以鞏固及擴充深圳寶安廠及深圳福田廠之營運。蘇州及深圳新廠房落成後，產能將提升約50條SMT生產線	53	53	53
• 資本開支			
– 於蘇州新廠房增設約30條SMT生產線	73*	155	155
– 於蘇州新廠房增設約10條SMT生產線	–	–	55
– 為現有廠房購置設備及增設約20條SMT生產線	105	105	105
– 為現有廠房購置設備及增設約5條生產線	–	–	26
• 擴充RMA中心、擴充市場推廣隊伍、改善管理資訊系統	15	15	15
總計	351	433	514

\* 結餘73,000,000港元指為蘇州新廠房增設約30條SMT生產線之首期付款。

## 未來計劃及全球發售所得款項用途

倘超額配股權獲全面行使，而發售價為建議發售價範圍每股1.60港元至2.30港元之中位數每股1.95港元，全球發售所得款項淨額將增至約501,000,000港元。董事現擬動用額外所得款項淨額68,000,000港元作可能收購SMT生產線之資金。倘若超額配股權獲全面行使，而假設發售價為每股2.30港元，全球發售之所得款項淨額將增加至約595,000,000港元。董事現擬動用額外所得款項淨額約81,000,000港元作可能收購或開設廠房之資金。倘所得款項淨額毋須即時撥作上述用途，則有關所得款項將存入持牌銀行或財務機構作短期存款，或用作購買貨幣市場工具。